



RE712001-LF

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Faccia singola 35 µm Cu
- Senza fori
- Stagnato a caldo (HAL senza piombo), rivestito con maschera di saldatura
- Stampa del componente
- Circuito con 85 elementi di costruzione standard, fine pitch e discreti:

tipo	numero
PLCC	52, 68, 20
QFP	44, 84, 132, 184 sq.
SOT23	3 x
SOT89	2 x
SOT143	1 x
SOT233	1 x
SO14	1 x
SOM16	1 x
SOL20	1 x
Poti.	1 x
DPAK	1 x
Al. Kond. 6,30 mm	1 x
Al. Kond. 4,00 mm	1 x
Melf 2308	2 x
Mini Melf 1206	6 x
Tantal Chip Kond. A	1
Tantal Chip Kond. B	1
Tantal Chip Kond. C	1
Tantal Chip Kond. D	1
0402 Chip Kond.	10 x
0603 Chip Kond.	10 x
1206 Chip Kond.	10 x
0805 Chip Kond.	10 x
1210 Chip Kond.	7 x
2220 Chip Kond.	1 x
1812 Chip Kond.	2 x
TSOP32	1 x
5020 Schwingquarz	1 x

- Adatto anche per l'attrezzatura meccanica (Pick & Place)
- Dimensioni 100 x 140 mm

20190909